

Wir suchen in Dresden zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

## **Ingenieur für Aufbau- und Verbindungstechnik (w/m/div) in der Produktion**

### **Ihre Aufgaben:**

Sie betreuen Anlagen und Technologien in der Chipmontage für Prozesse wie:

- Wafersägen
- Chipbonden
- Drahtbonden
- Verschluss von Keramik- und Metallgehäusen
- Elektrische Endmessung
- Prozesskontrolle
- Qualitätskontrolle

### **Was Sie mitbringen:**

- Abgeschlossenes Studium Aufbau- und Verbindungstechnik, Mikrosystemtechnik oder vergleichbare technische Ausbildung
- Erfahrung auf dem Fachgebiet von Vorteil
- Eigenständige Arbeit an mehreren Prozessen
- Sorgfalt und hohe Leistungsbereitschaft
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

### **Was wir bieten:**

- Unbefristete Festanstellung in Vollzeit
- Vielseitiges Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum
- Aufgeschlossenes, innovatives Team
- Optimale Verkehrsanbindung
- Überdurchschnittlicher Urlaubsanspruch
- Attraktive Zusatzleistungen, z. B.: Fahrtkostenzuschuss, Kindergartenzuschuss

**Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:**

**Steffen Zietzschmann**  
**SAW COMPONENTS Dresden GmbH**  
Manfred-von-Ardenne-Ring 7  
01099 Dresden  
zietzschmann@sawcomponents.de  
0351 88725-10  
www.sawcomponents.de